

耐フラックス残さ亀裂対応、車載用次世代ペースト

Crack-free flux residue next generation paste for automotive

TLF-204-GTS-VR1 SERIES

特長
Feature

・フラックス残さの耐亀裂性と作業性を大幅に向上させた、次世代高信頼性のソルダーペースト

This is the next generation high reliability solder paste whose anti-cracking performance of flux residue and process-ability was improved significantly.

製品コンセプト Product concept

より高い信頼性の求められる車載製品に対応し、ペーストの特性を向上させる。

- ・冷熱サイクル時のフラックス残さの耐亀裂性向上。
- ・マスク厚を維持したままでの、微細開口部への印刷性の向上。
- ・ボイド面積率の低減。

Improve solder paste properties for high reliable automotive devices

- ・ Improve ability of anti-cracking during TCT
- ・ Improve print-ability with the same mask thickness
- ・ Decreasing voiding area rate

製品概要 Product outline

ハンダ合金組成 Alloy composition	Sn-3Ag-0.5Cu
融点 Melting point	216-221℃
リフロープロファイル Reflow profile	SAC305プロファイル Profile
リフロー雰囲気 Reflow atmosphere	N2 1000ppm以下

特長 Features

-40⇔125℃3000cyc後のフラックス残さの状態

Flux residue appearances after 3000 cycles under -40⇔125℃

<従来品> Conventional



冷熱後のフラックス残さ連結亀裂発生
Connected cracks observed after TCT

<次世代品> Next generation



冷熱後のフラックス残さ連結亀裂発生無し
No connected cracks observed after TCT

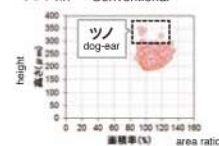


改良後
Improved

マスク厚160umでの0.5mmPスリット部における印刷面積率の分布比較

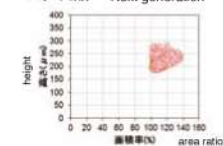
Print area ratio comparison slit area (Stencil thickness: 160um)

<従来品> Conventional



印刷面積率のバラツキに課題有り
An issue of random variation of print area ratio

<次世代品> Next generation



印刷面積率のバラツキの低減
Random variation reduction of print area ratio



改良後
Improved